



HGW FLUID 0

产 品 规 格 书

标准

ISO 17672 标准：CuP 385

AWS A5.8 标准：BCuP-9

成分(w.%)

Cu: 余量 | P: 7.0-7.5 | Sn: 6.0-7.0 | Si: 0.01-0.4 | 其他: ≤ 0.25

技术性能

固相线 (°C): 635

固相线 (°F): 1178

推荐钎焊温度 (°C): 645-695

导电率 (%IACS): 5-6

伸长率: 30-39

密度 (g/cm³): 7.94

· 液相线 (°C): 675

· 液相线 (°F): 1247

· 推荐钎焊温度 (°F): 1190-1280

· 电阻率 ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$): 0.33

· 抗拉强度 (MPa): 740-775

可制造能力

焊丝直径范围 (mm): $\phi 0.8 - \phi 2.0$ (盘装) / $\phi 2.0$ 及以上 (卷装)

棒材直径与长度范围 (mm):

直径: 1.2-3.0 / 长度: 1-1000

其他形式: 焊环

应用

用途: 适用于铜及铜合金的钎焊。

特点: 该合金因含锡, 熔化温度相对较低; 流动性极佳, 适用于微小间隙的焊接场景; 塑性较差, 因此不适用于有振动工况的接头部位。

储存条件

本产品应密封储存, 储存环境应保持干燥、通风良好。不得与酸、碱等挥发性及腐蚀性物质混存。